

## 成都振芯科技股份有限公司 关于签署《保证合同》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、担保情况概述

经成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月16日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于为子公司申请银行贷款提供担保》的议案，具体内容详见公司于2020年10月20日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的公告》（公告编号：2020-061）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的相关规定，公司上述对子公司提供担保事项由董事会审议通过后实施，无需经公司股东大会审议或政府有关部门批准。

### 二、保证合同的主要内容

近日，公司（以下称“保证人”）与中国工商银行成都高新技术产业开发区支行（以下称“工商银行”）签署完成编号为0440200055-2020年高新（保）字0083号的《保证合同》，主要内容如下：

1、保证的方式：连带责任保证。

2、被担保的主债权：（1）保证人所担保的主债权为工商银行依据其与成都国翼电子技术有限公司（以下称“债务人”）签订的主合同（名称：流动资金借款合同；编号：0440200055-2020年（高新）字01267号）而享有的对债务人的债权。（2）主债权的金额和期限依主合同之约定。

3、保证期间：自主合同项下的借款期限届满之次日起两年；工商银行根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起两

年。

### 三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

上述担保金额占公司 2019 年度经审计归属于上市公司净资产的 4.63%。截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保余额为 18,300 万元，占公司 2019 年度经审计归属于上市公司净资产的 19.69%。

截至本公告日，公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

### 四、备查文件

- 1、成都振芯科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议。
- 2、与中国工商银行成都高新技术产业开发区支行签署的《保证合同》。

特此公告。

成都振芯科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 11 月 3 日